

471-5LLHV

厚膜披覆、PCB 保密绝缘封胶

UL File No. E100866 \ E333984 \ E87039

特点

- 耐燃性符合 UL94 V-0。
- 低放热,低收缩,散热性良好。
- 收缩小,不会拉坏细线路及 Core,对电感(L值)影响极小。
- 不垂流,适合点胶密封、保密要求、直接涂抹或浸涂作业。
- 操作时间长,适合手工操作或是大量使用。

基本物性

| | | | <u>主剂(B 剂)</u> | | | 硬化剂(A 剂) | | | | | |
|-----|---|---|----------------|---|---------|----------|-----------|-------------|---|-----------|--|
| 颜 | | | 色 | : | | | 黑 | [色 | | 琥珀色 | |
| 黏 | | | 度 | : | @25°C | | 200,000-2 | 270,000 cps | 6 | 20-50 cps | |
| 比 | | | 重 | : | @25°C | | 1.62 | 2-1.67 | | 0.93-0.98 | |
| 闪 | 火 | | 点 | : | (ASTM D | 93) | >9 | 04°C | | 90°C | |
| 重 量 | 混 | 合 | 比 | : | (主剂: 硬 | 化剂) | 1 | 00 | : | 15 | |
| 体 积 | 混 | 合 | 比 | : | (主剂:硬 | 化剂) | 1 | 00 | : | 25 | |

混合后物性

混 合 后 黏 度 : @25°C (ASTM D2196) 25,000-35,000 cps (摇变性、糊状)

可操作时间: @25°C 150分钟

胶 化 时 间 : @25°C、150克 400 - 500分钟

硬 化 条 件: 25°C x 24 小时 或

80°C x 4 小时

(硬化后放置7天到达完整物性)

傑地有限公司 www.jasdi.com.tw

台北: 886-2-26008672 台中: 886-4-25685848 东莞: 86-769-88188707 苏州: 86-512-66106145

杰研贸易(上海)有限公司

www.jasdi.com.cn • jasdi@jasdi.com.cn TEL: 021-58356975 • FAX: 021-58356976

机 械 特性 (样品放置室温 7天后,到达完整物性)

耐燃性: UL 94、2.9mm 厚 V-0

硬 度: Shore D 75-85

抗 张 强 度: (ASTM D229) 5,650 psi (39 MPa)

断 裂 延 伸 率 : (ASTM D229) 5 %

弯 曲 强 度: (ASTM D790) 5,950 psi (41 MPa)

玻璃转化温度(Tg) : DSC 48 - 53 °C

热 膨 胀 系 数 : Tg 前 4 x 10⁻⁵ IN/IN/°C

Tg 后 1.95 x 10⁻⁴ IN/IN/°C

热 传 导 系 数 : 0.5 – 0.6 W/mK

 $(0.29 - 0.35 \text{ BTU/Hr/FT}^{2/}\text{FT/}^{\circ}\text{F})$

吸 水 率: @25°C、浸水 168 小时 0.4 %

重 量 损 失 率 : @135°C、浸水 168 小时 0.5 %

电气特性

绝 缘 强 度 : (ASTM D149)、125mils 刚硬化后 510 Vpm (20 kV/mm)

浸水 24 小时 480 Vpm (19 kV/mm)

绝 缘 常 数 : @25°C、1KHz 4.2

消 散 因 素 : @25°C、1KHz 0.03

体 积 电 阻: @25°C (ASTM D257) 1.5 x 10¹⁴ ohm-cm

注 意 事 项

- 471-5LLHV 产品设计硬化速度较为缓慢,以便使用于电子零件或电气组件,产生较小的应力变化。
- 如果需要快速生产,可利用烘烤加速树脂硬化(建议不超过80°C)。
- 如欲以高温烘烤硬化,对于涂层厚度较厚、或较敏感组件固定等应用时,请先于室温静置数小时。待树脂胶化后,再放入烘箱烘烤,以期得到较好的表面,以及较小的应力变化。